

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2024-014

## 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	逸豪新材	股票代码	301176
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	LIU LEI	钟子宜	
办公地址	江西省赣州市章贡区冶金路 16 号	江西省赣州市章贡区冶金路 16 号	
传真	0797-8334198	0797-8334198	
电话	0797-8339625	0797-8339625	
电子信箱	dmb@yihaoxincai.com	dmb@yihaoxincai.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主营业务

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略。报告期内，公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式近年来未发生重大变化。

公司在电子电路铜箔和 PCB 领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司主要客户包括生益科技、南亚新材、鹏鼎控股、景旺电子、龙宇电子、胜宏科技、中富电路、依顿电子、世运电路、格力电器、兆驰光元、聚飞光电、TCL、视源股份等。公司产品能够有效满足客户对产品性能、规格、质量等各项要求，树立了良好的市场口碑。

#### （二）公司主要产品

##### 1、电子电路铜箔

电子电路铜箔系以铜为主要原料，采用电解法生产的铜箔，主要作为覆铜板、印制电路板中用于连接各个电子元器件的导体，是覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）生产的主要材料之一。

基于公司一体化产业链优势，公司对 PCB 客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应 PCB 客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合 PCB 客户

铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。公司电子电路铜箔产品规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔等种类，覆盖范围广泛，主要产品规格有 9 $\mu\text{m}$ 、12 $\mu\text{m}$ 、15 $\mu\text{m}$ 、18 $\mu\text{m}$ 、28 $\mu\text{m}$ 、30 $\mu\text{m}$ 、35 $\mu\text{m}$ 、50 $\mu\text{m}$ 、52.5 $\mu\text{m}$ 、58 $\mu\text{m}$ 、70 $\mu\text{m}$ 、105 $\mu\text{m}$ 、140 $\mu\text{m}$ 、175 $\mu\text{m}$  等，销售最大幅宽为 1,325mm。

## 2、铝基覆铜板

铝基覆铜板属于金属基覆铜板的一种，由导电层、绝缘层、金属基层组成，其中导电层经过蚀刻可形成印制电路，绝缘层主要起粘接、绝缘和导热的功能，金属基层主要用于满足铝基覆铜板的散热、机械性能等需求。公司凭借自有铜箔生产线的垂直产业链优势，可以根据下游客户的个性化需求，进行铝基覆铜板产品的定制化生产。




公司掌握了铝基覆铜板全制程生产技术，公司铝基覆铜板产品使用自产电子电路铜箔，具有技术先进、规格齐全、品质稳定、交期及时、低成本等优势。公司铝基覆铜板主要应用于 LED 下游应用行业，如 LED（含 MiniLED）背光、LED 照明等。2023 年，公司铝基覆铜板在高瓦数导热产品方面取得重大突破，开发出了 5W 高导热铝基覆铜板，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域。


## 3、PCB

印制电路板（PCB）主要为电子信息产品中的电子元器件提供预定电路的连接、支撑等功能，发挥了信号传输、电源供给等重要作用。公司主要为 LED、电子信息制造业相关领域的客户提供定制化的 PCB 产品。目前公司 PCB 产品主要为单面铝基 PCB、双多层 PCB。

公司已研发出可应用于 Mini LED 的铝基 PCB 产品，可满足下游 Mini LED 领域客户对技术指标、产品性能等要求，公司铝基 Mini LED PCB 产品已经应用于 TCL 和海信的电视产品中。公司 PCB 产品已通过 IATF16949 汽车产品质量管理体系认证，应用于汽车尾灯产品中，公司 PCB 产品通过 ISO13485 医疗体系认证及试产。

公司主要产品介绍如下：

名称	产品	产品下游	终端应用
电子电路铜箔		覆铜板、PCB	消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车等
铝基覆铜板		铝基 PCB	LED（含 MiniLED）背光、LED 照明等
PCB	 (铝基 PCB)	LED 照明、消费电子、通讯电子、汽车电子等	LED（含 MiniLED）、仪表盘、车灯、GPS、影音系统、工控电源、电力电源、UPS、5G 通讯、智能制造、智能家电、物联网等

	 <p style="text-align: center;">(双多层 PCB)</p>		
--	--	--	--

### (三) 经营模式

#### 1、盈利模式

报告期内，公司主要通过为客户提供电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品来获取合理利润。公司紧跟下游行业发展趋势，不断进行研发和技术创新，对生产工艺进行优化改进，能够快速响应市场的变化和下游客户的需求，同时通过提高运营管理能力以降低经营成本，提升公司的行业竞争力和盈利能力。

#### 2、采购模式

报告期内，公司外购的原材料主要原材料为铜、铝板，其中铜是电子电路铜箔生产的主要原材料；铝板和电子电路铜箔（自产）是铝基覆铜板生产的主要材料；铝基覆铜板（自产）和 FR4 覆铜板是公司 PCB 的主要材料。铜和铝属于大宗商品，市场价格透明，货源充足。公司拥有稳定的采购渠道，与供应商建立了良好的合作关系。

公司建立了较为完善的采购管理体系，下设供应部，负责采购的实施和管理，根据销售计划和生产需求定期制定采购计划。公司制定了《合格供应商名录》，从质量、交货周期、供货价格和服务等方面对供应商进行考核，确保原材料供应的品质合格、货源稳定，控制原材料的采购成本。

#### 3、生产模式

公司建立了较为完善的生产管理体系，公司电子电路铜箔生产具有连续生产特点，公司综合考虑铜箔产能与客户订单情况制定生产计划。公司铝基覆铜板生产结合行业需求、客户订单情况制定生产计划。公司 PCB 生产根据客户订单情况制定生产计划。生产部门根据客户需求进行工艺配置，根据生产计划安排生产。在生产过程中，品质部门和生产部门定时、定量对生产各个工序的在产品进行性能检测和外观监控，对产品生产全流程进行质量监控和管理。产品经品质部检验后包装入库。

#### 4、销售模式

公司拥有优质且长期合作稳定的客户群体，主要以上市公司以及细分行业的龙头企业为主，同时存在少量贸易商。一方面公司通过定期的品质回访，与客户研发团队定期开展技术交流，响应客户最新需求，有针对性地进行客户维护以及新产品的开发；另一方面公司通过行业研讨会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径，主动选择发展前景良好与自身发展战略匹配的公司，有针对性地进行新客户开发，创造业务合作的机会。

公司电子电路铜箔产品采用“铜价+加工费”的定价模式，以长江有色金属现货铜价作为基准铜价，根据铜价、加工费、产品规格等因素，并综合考虑市场供需关系，与客户协商确定。

公司铝基覆铜板产品销售价格系根据生产成本，并参考市场价格、供需关系等因素，与客户协商确定。PCB 产品销售价格系根据生产成本、生产工艺等因素，与客户协商确定。

公司 PCB 产品销售价格系根据生产成本、生产工艺等因素，与客户协商确定，采用向下游客户直接销售为主，贸易商代理为辅的销售模式。目前公司在交付过程中，分为直接交货到客户与寄售模式。寄售模式为公司根据客户订单需求进行生产后，将货物运送到客户指定仓库或者第三方仓库，客户领用后进行对账与

结算。

#### （四）公司产品市场地位、竞争优势与劣势

##### 1、公司产品市场地位

电子电路铜箔是覆铜板和印制电路板制造的重要材料，印制电路板作为现代各类电子设备中的关键电子元器件，广泛应用于消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、工控医疗等众多领域。

公司深耕于电子电路铜箔及 PCB 行业，公司客户主要以上市公司以及细分行业的龙头企业为主，先后与行业内知名企业建立了稳定的合作关系。作为行业内为数不多的具有 PCB 垂直一体化产业链布局的企业，公司掌握电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 生产核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司铝基覆铜板使用自产铜箔，公司 PCB 产品使用自产铜箔和铝基覆铜板，具有技术先进、规格齐全、品质稳定、交期及时、低成本等优势。并且随着公司产品的产销量扩大、客户数量和质量的提升、产品及工艺技术升级，公司的市场竞争力和市场地位也在提高，公司是行业内少数同时掌握电子电路铜箔、铝基覆铜板及 PCB 生产研发技术的企业，拥有产品串联研发，快速匹配下游新产品开发的能力。

公司坚持“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，致力于成为电子材料领域领先企业。公司系国家高新技术企业、江西省“专精特新”中小企业，公司技术中心已入选为江西省省级企业技术中心，公司电子电路铜箔系江西省名牌产品。公司具备较强的研发实力，注重工艺技术提升，经过多年的研发，公司已取得 125 项专利，其中发明专利 36 项，实用新型专利 89 项。公司建立了完善的管理体系，通过了知识产权管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系和安全生产标准化 III 级企业等认证。此外，公司电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品符合 RoHS、REACH 等的要求，铝基覆铜板通过 ULCCN:QMTS2 MOT130 认证；PCB 产品已通过中国 CQC、美国 UL、IATF16949、ISO13485 医疗体系认证。公司产品满足了客户对产品性能、规格、质量等各项要求，树立了良好的市场口碑，赢得了市场的信任。

##### 2、竞争优势与劣势

###### （1）竞争优势

###### ①垂直一体化产业链优势

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略。报告期内，公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。公司 PCB 项目一期已于 2021 年第三季度开始试生产，随着公司 PCB 项目的投产，公司垂直一体化产业链优势得到进一步加强，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司实现了 PCB 关键材料的自产，有利于公司产品质量水平的长期稳定，同时关键原材料自产也为公司产品带来了成本优势。

###### ②客户资源优势

公司在铜箔行业深耕十余年，经过多年发展，依靠稳定的产品供给、过硬的产品质量、完善的服务体系赢得了众多知名客户的信赖，与行业内知名企业建立了稳定的合作关系。经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸至铝基覆铜板及 PCB。公司的主要客户多为行业内的标杆企业，具有良好的市场形象及商业信誉，在行业中处于领先地位。通过进入该等客户的供应商体系，有利于公司获得行业内潜在客户的认可，便于公司业务持续快速拓展；同时下游客户对公司产品各方面性能指标的高标准严格要求，有助于推动公司持续不断进行技术创新和产品研发，稳固公司的研发和产品优势。

###### ③柔性化生产优势

PCB 在叠板和压合过程中根据不同的排板组合需要不同幅宽的铜箔，同时 PCB 产品下游应用领域广泛，

不同应用领域对 PCB 产品及其所用铜箔亦有不同的厚度和性能要求。基于产业链优势，公司对 PCB 客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应 PCB 客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合 PCB 客户铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。公司电子电路铜箔产品规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔等种类，覆盖范围广泛，主要产品规格有 9 $\mu\text{m}$ 、12 $\mu\text{m}$ 、15 $\mu\text{m}$ 、18 $\mu\text{m}$ 、28 $\mu\text{m}$ 、30 $\mu\text{m}$ 、35 $\mu\text{m}$ 、50 $\mu\text{m}$ 、52.5 $\mu\text{m}$ 、58 $\mu\text{m}$ 、70 $\mu\text{m}$ 、105 $\mu\text{m}$ 、140 $\mu\text{m}$ 、175 $\mu\text{m}$  等，销售最大幅宽为 1,325mm。

公司的柔性化生产管理增强了客户粘性，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，同时公司在 PCB 行业中的客户积累和良好口碑，有利于公司获得 PCB 行业内潜在客户的认可，便于公司业务持续快速拓展，提升了公司柔性化生产的规模化效应。

#### ④技术研发优势

公司高度重视产品、技术的研发和提升，不断提高研发投入。公司在全面发展生产技术的同时，始终紧跟下游行业的发展趋势，专注于本领域的技术研发，形成并拥有多项自主研发的核心技术，包括电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术，电解铜箔表面处理机设计及工艺优化技术，抗剥高温耐衰减、深度细微粗化表面处理工艺技术，铝基覆铜板全自动连线生产技术，铝基覆铜板用涂胶铜箔工艺配方及生产技术，铝基 Mini LED PCB 工艺技术，汽车 PCB 工艺技术等。公司已取得专利 125 项，其中发明专利 36 项，实用新型专利 89 项。

经过多年发展，公司逐步掌握了铜箔生产后处理设备的研发、设计与操作工艺，具备设备创新研发能力。公司铜箔后处理设备采用自主设计、零部件委托加工、自主组装的模式，提升了设备的适用性和先进性，提高了生产效率和产品品质，提升了公司的竞争能力。

#### ⑤产品优势

公司电子电路铜箔产品的规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔，覆盖范围广泛，主要产品规格有 9 $\mu\text{m}$ 、12 $\mu\text{m}$ 、15 $\mu\text{m}$ 、18 $\mu\text{m}$ 、28 $\mu\text{m}$ 、30 $\mu\text{m}$ 、35 $\mu\text{m}$ 、50 $\mu\text{m}$ 、52.5 $\mu\text{m}$ 、58 $\mu\text{m}$ 、70 $\mu\text{m}$ 、105 $\mu\text{m}$ 、140 $\mu\text{m}$ 、175 $\mu\text{m}$  等，销售产品最大幅宽为 1,325mm。多年来，公司持续跟踪市场变动趋势和客户产品需求，提升产品的各项性能指标。通过多年来持续的研发和工艺改进，公司铜箔产品由常规 STD 铜箔持续升级演进，在产品厚度、粗糙度、抗拉性、延伸性、耐热性、抗剥离强度等性能指标上不断研发创新，目前公司已研发并批量生产 HDI 用超薄铜箔和 105 $\mu\text{m}$ 、140 $\mu\text{m}$ 、175 $\mu\text{m}$  厚铜箔等原先依赖进口的高性能铜箔；高频高速铜箔方面，HVLP 铜箔、RTF 铜箔已向客户送样，目前正处于测试验证阶段。公司 2023 年研发出 9 $\mu\text{m}$  超薄铜箔和 140 $\mu\text{m}$ 、175 $\mu\text{m}$  厚铜箔产品，其中 140 $\mu\text{m}$  和 175 $\mu\text{m}$  铜箔目前已向客户批量供货，产品性能稳定，9 $\mu\text{m}$  铜箔已向海外客户送样。公司电子电路产品结构方面，超薄和厚铜箔占比进一步增大。公司铝基覆铜板产品，研发出 5W 高导热铝基覆铜板，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域。公司 PCB 产品铝基 Mini LED PCB 已经应用于 TCL 和海信的电视产品中，公司 PCB 已通过 IATF16949 汽车产品质量管理体系认证，已应用于汽车尾灯产品中，认证通过 ISO13485 医疗体系认证及试产。

#### (2) 竞争劣势

公司经过多年发展，积累了丰富的电子电路铜箔生产技术，掌握了多项核心技术。其中高频高速铜箔方面，HVLP 铜箔、RTF 铜箔已向客户送样，但公司受限于现有生产线，无法大批量生产该类高频高速铜箔，公司募投项目“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”具备专线生产高频高速铜箔的条件，在募投项目投产后，高频高速铜箔可实现批量供货。

公司 PCB 产能尚处于爬坡阶段，公司通过持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，报告期内公司 PCB 业务的产量和营收相较 2022 年度均取得较大幅度增长，但因公司 PCB 整体产能尚未达产，产能规模优势尚未体现，导致产品单位成本较高，同时公司 PCB 产品结构尚在优化调整中，部分目标客户在认证过程中。公司计划在 2024 年度，持续调整 PCB 产品结构、提升产能利用率，加速产能释放，充分发挥 PCB 产业链垂直一体化优势。

## （五）报告期内主要业绩驱动因素及报告期内业绩情况

### 1、报告期内主要业绩驱动因素

国家产业政策、行业供需情况、行业竞争情况、技术创新能力等因素为业绩驱动的关键因素。

#### （1）国家产业政策

电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。国家政策的支持是公司持续发展的有力保障。行业政策变动是影响公司盈利能力重要的因素之一。

#### （2）行业供需情况

公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 的下游应用市场较为广阔，终端应用涵盖了消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、工控医疗、航空航天等行业，庞大的电子信息产业终端市场为铜箔行业提供了广阔的市场空间。但电子信息产业终端产品的需求受产业链上下游供需关系、消费市场状况等多重因素的影响，下游需求旺盛时，带动 PCB 及下游铜箔等材料行业需求的发展，提升行业景气度，另一方面，近年来，在新能源、汽车行业的带动下，铜箔行业扩产速度加快，电子电路新增产能释放或拟建锂电铜箔产能向电子电路铜箔产能转移，则可能会导致铜箔行业供给增加，行业竞争加剧，改变铜箔行业的市场供需情况，进而影响铜箔行业企业的业绩水平。

#### （3）行业竞争情况

随着终端应用市场的发展，电子电路铜箔行业的景气度提升。电子电路铜箔的市场需求量将会持续增长，将吸引越来越多新企业进入或现有企业扩大生产规模，加剧行业竞争。整体而言，新进入厂商技术积累、研发能力、客户积累等较为薄弱。

随着 AI 技术的快速发展、5G 通信技术的应用、汽车电子产品技术的更迭，行业下游客户的产品性能更新加速，消费者偏好变化加快，在此背景下，拥有领先的技术研发实力、高效的产品批量供货能力、良好的产品质量、优质客户资源的铜箔企业才能在市场竞争中拥有竞争优势，获得更大的市场份额。

#### （4）技术创新能力

技术创新是公司保持持续发展的核心驱动力，对公司的长期盈利能力具有重大影响。技术提升、工艺改进将提高公司产品的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

### 2、报告期内业绩情况

2023 年度，因终端消费需求疲软，行业内新增产能较大等因素影响，铜箔行业竞争加剧，行业内铜箔加工费整体大幅下滑，报告期内公司铜箔加工费、销售单价、毛利率均大幅下滑。PCB 方面，2023 年度，公司 PCB 产能仍处于爬坡阶段，公司通过持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，报告期内公司 PCB 业务的产量和营收相较 2022 年度均取得较大幅度增长，但因公司 PCB 整体产能尚未达产，产能规模优势尚未体现，导致产品单位成本较高，同时公司 PCB 产品结构尚在优化调整中，部分目标客户在认证过程中，在上述因素的影响下，报告期内 PCB 业务尚未能全面实现盈利，对公司业绩仍产生负向影响。

从中长期看，电子产业仍将保持稳定增长态势。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性支柱产业，电解铜箔、覆铜板和 PCB 作为电子信息产业的基础产品，是国家鼓励发展的重要产业，其发展受到国家主管部门出台的一系列产业政策支持。随着 AI、5G 基站、互联网数据中心（IDC）、汽车电子、消费电子等下游产业的快速发展，将驱动 PCB 以及 PCB 原材料市场保持稳健增长。据 PrismaMark 预测，2024 年电子产业规模为 2.573 万亿美金，同比增长 6%，2024 年起 PCB 全线将恢复正增长，2022 年至 2027 年 RPCB 多层板、软板+模块、HDI、IC 载板四大产品线年均复合增长率分别为 3.1%、3.5%、4.4%、5.1%。



## （六）公司经营计划

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。为实现公司战略目标，公司制定经营计划如下：

### 1、横向扩张铜箔产能、优化产品结构、拓展应用领域

公司将在现有产能规模上，持续提升超薄铜箔和厚铜箔的产量，巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额。同时随着公司募投项目“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”的稳步实施，力争部分生产线在 2024 年二季度投产，该项目以生产高性能电子电路铜箔以及超薄高抗拉锂电铜箔为主。随着募投项目产能的释放，公司将大幅提升超薄铜箔、厚铜箔等高端电子电路铜箔的产能，同时也具备生产高频高速铜箔的能力；此外，公司通过研发线的中试，已掌握了 4.5 μm 高抗拉锂电铜箔的生产工艺技术。公司募投项目的设备及工艺，可实现电子电路铜箔和锂电铜箔切换生产，公司将加快锂电铜箔业务布局，将铜箔产品拓展至锂电铜箔领域。

### 2、纵向打通产业链，强化产业协同效应

经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸至铝基覆铜板以及下游 PCB。公司垂直一体化产业链优势可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司 PCB 业务将科技创新与新旧产业进行融合，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，另一方面主动选择发展前景良好与公司发展战略匹配的领域进行重点布局，持续创新，加强技术和人才储备。2024 年度，公司 PCB 将持续推进产品的更新迭代，加强公司 PCB 产品结构的多样性及创新性。单面铝基 PCB 将由普通灯条、侧入式 PCB 转型为以 Mini LED PCB 为主的产品结构；双面多层 PCB 将由普通电子消费类产品转型高阶 Micro LED PCB、汽车产品 PCB。公司 PCB 计划在 2024 年度，提升产能利用率，加速产能释放，单面铝基 PCB 2024 年度产量提升 60%，双面多层 PCB 2024 年度产量提升 65%。

### 3、持续提高技术研发水平及研发成果转化

公司将持续加大研发投入，密切关注前沿技术的发展，结合终端客户市场需求，匹配下游新产品开发。电子电路铜箔方面，公司 2024 年度将着力加强适用于不同树脂体系的高频高速铜箔的研究、易剥离极薄载体铜箔的开发、6-12OZ 超厚铜箔的开发；铝基覆铜板方面，2024 年度公司将着力于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究；PCB 方面，2024 年度公司将加大高阶 Micro LED PCB、LED 铝基“U”型 PCB 的技术研发。公司将利用研发成果，持续推出新产品，提升产品竞争力，加大实现高端产品进口替代的力度，进一步强化公司的核心竞争力。

### 4、强化业务团队建设

经过多年发展，公司已经与生益科技、南亚新材、鹏鼎控股、景旺电子、龙宇电子、胜宏科技、中富电路、依顿电子、世运电路、格力电器、兆驰光元、聚飞光电、TCL、视源股份等行业内知名企业建立了稳定的合作关系，市场的知名度不断提高。为实现公司战略目标，公司将进一步加强业务团队建设，引进优秀的销售人才，扩大业务团队规模，积极开拓新客户，为公司新业务的开展奠定基础，进一步提高公司的市场占有率。

### 5、加强人才引进

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,074,460,685.28	2,202,380,762.63	2,202,493,858.64	-5.81%	1,520,516,916.50	1,520,704,199.15
归属于上市公司股东的净资产	1,615,836,522.96	1,667,387,900.53	1,667,389,716.59	-3.09%	693,616,453.56	693,618,269.62
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,276,737,812.45	1,334,709,512.90	1,334,709,512.90	-4.34%	1,271,049,881.46	1,271,049,881.46
归属于上市公司股东的净利润	32,955,860.26	70,325,814.86	70,325,814.86	-146.86%	162,841,557.49	162,841,557.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,940,759.77	54,027,793.81	54,027,793.81	-166.52%	153,773,110.75	153,773,110.75
经营活动产生的现金流量净额	30,655,086.51	13,312,585.47	13,312,585.47	-330.27%	22,357,333.78	22,357,333.78
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.51	0.51	-137.25%	1.28	1.28
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.51	0.51	-137.25%	1.28	1.28
加权平均净资产收益率	-2.01%	7.37%	7.37%	-9.38%	26.60%	26.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

#### (2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	295,388,250.03	298,861,835.51	358,678,301.52	323,809,425.39

归属于上市公司股东的净利润	-2,776,984.67	-8,324,027.71	-3,992,114.42	-17,862,733.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,440,694.69	-8,842,610.07	-5,115,454.83	-18,542,000.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,228,246.35	-13,786,373.10	1,949,178.58	45,410,354.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,302	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
赣州逸豪集团有限公司	境内非国有法人	52.06%	88,022,985.00	88,022,985.00	不适用				0.00
香港逸源有限公司	境外法人	10.65%	18,004,048.00	18,004,048.00	不适用				0.00
赣州发展投资基金管理有限公司—赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8.33%	14,088,889.00	0.00	不适用				0.00
张剑萌	境内自然人	3.95%	6,684,078.00	6,684,078.00	不适用				0.00
国信证券—招商银行—国信证券逸豪新材员工参与战略配售集	其他	0.95%	1,612,227.00	0.00	不适用				0.00

合资产管理计划						
UBS AG	境外法人	0.52%	874,655.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.41%	687,400.00	0.00	不适用	0.00
国信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	574,423.00	0.00	不适用	0.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.26%	447,234.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.26%	446,752.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 张剑萌持有赣州逸豪集团有限公司 100%的股权；张信宸持有香港逸源有限公司 90%的股权；张信宸系张剑萌之子，两人共同为公司实际控制人。 (2) 除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
UBS AG	新增	0	0.00%	874,655	0.52%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	687,400	0.41%
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	447,234	0.26%
中国国际金融股	新增	0	0.00%	446,752	0.26%

份有限公司					
何朝阳	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市小四喜资产管理有限 公司 —小四喜长江 1 号私募证券投资 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
梁尚青	退出	0	0.00%	0	0.00%
韩东学	退出	0	0.00%	445,000	0.26%

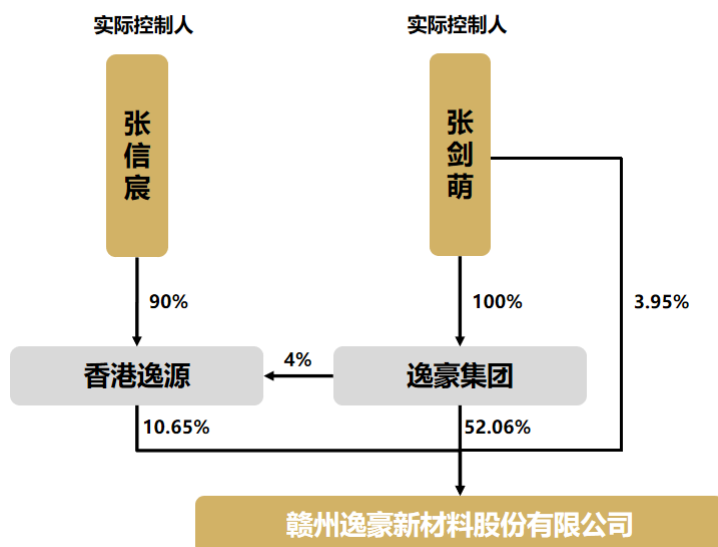
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无